

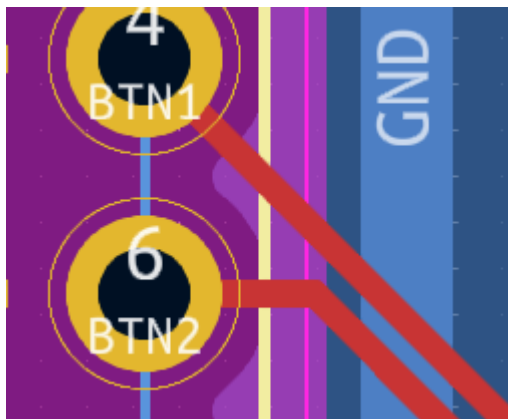
Anotaciones placas general

- 1) Separar las pistas de los pads de soldaduras, en especial cuando son finitas porque en la manipulación de soldado/desoldado, la temperatura podría perjudicar la pista y levantarse, recomendando separarla un poco más aprovechando que hay espacio



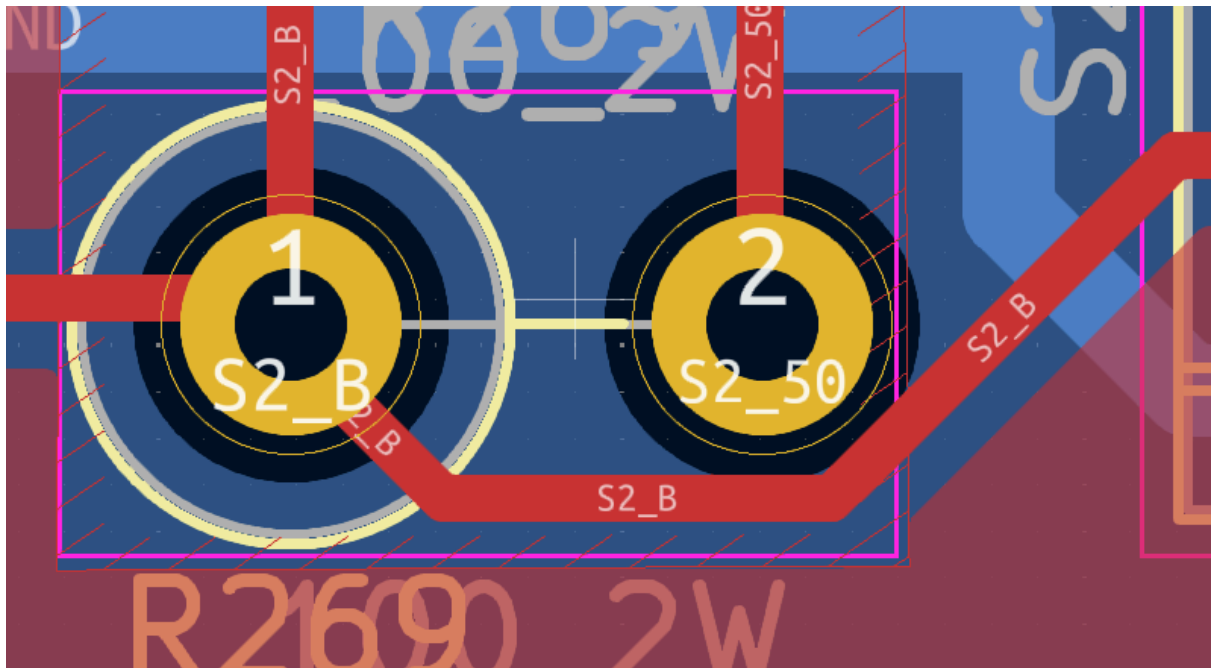
Se modificó conexiones FRENTE con zócalo de placa. Y se revisaron el resto. Se siguió este criterio siempre que fue posible.

- 2) Entraría al pad de soldar recto como el resto para ser armonioso con el resto de los pads

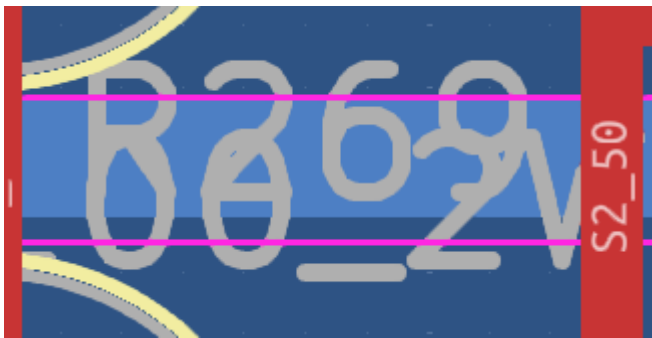


Se modificó conexiones FRENTE con zócalo de placa. Y se revisaron el resto. Se siguió este criterio siempre que fue posible.

- 3) Igual que en punto 1 , separaría y respetaría la circunferencia de los pads de soldadura para evitar problemas a futuro en la manipulación en especial por reparaciones



- 4) Separar la capa de identificación de otra manera para que no se superpongan y a la hora se armado no haya confusiones



Revisado y corregido.

- 5) Se repite, tener cuidado con esto, es altamente recomendable que no haya duplicidad y en lo posible que la identificación esté solamente de un lado de la placa

Esta repetición reside en que una cosa es la serigrafía (F. Silkscreen y B. Silkscreen) y otra la marca para el armador (F. Fab y B. Fab). El Kicad ya lo trae así "duplicado" por defecto y sacarlo sería un trabajo de modelo por modelo. Lo que debe hacerse es que a la hora de imprimir las marcas F. Fab y B. Fab, no se imprimen las serigrafías (que se verán en la placa).

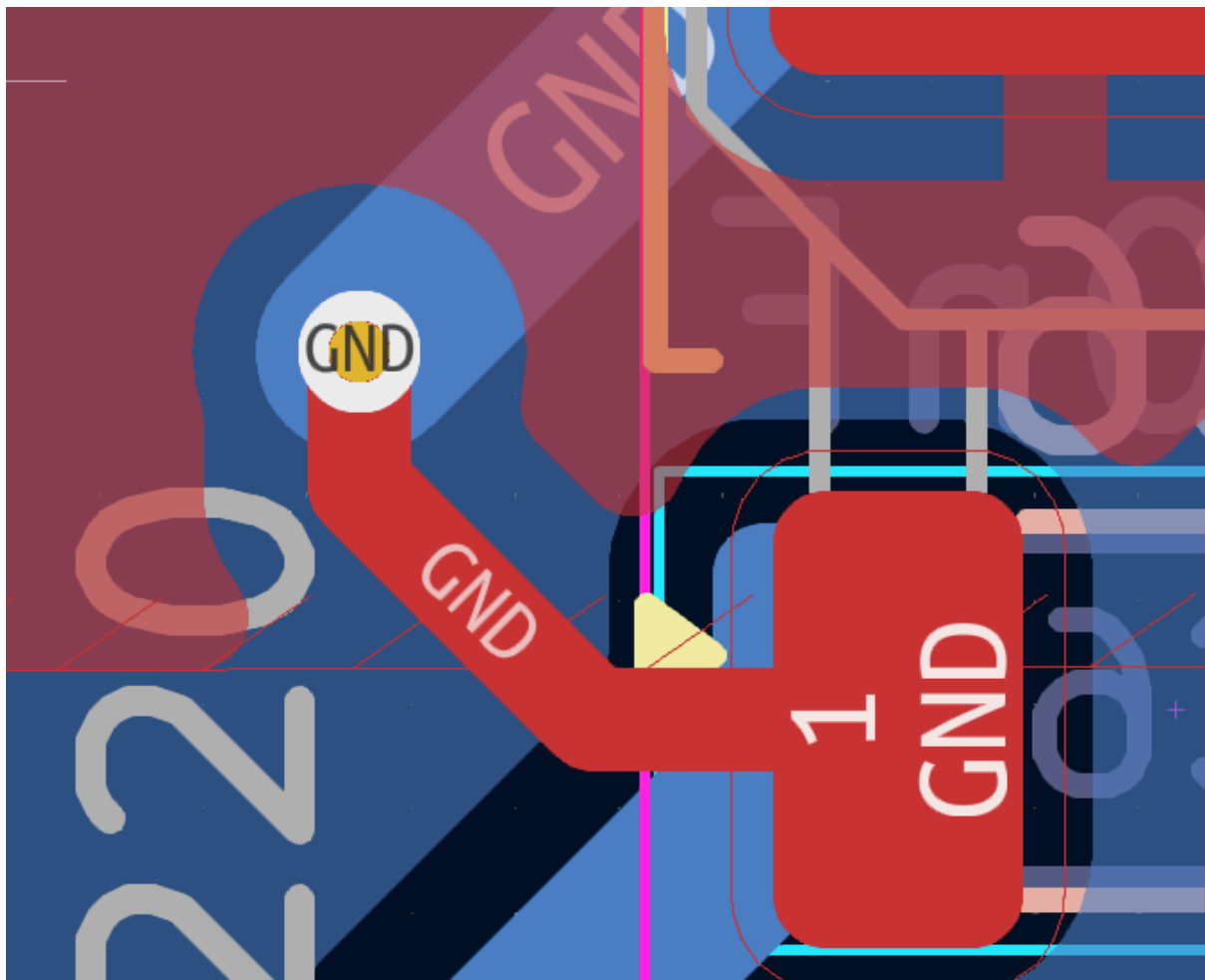


6) Podrían estar alineados ?

Están alineados los cuerpos de los tbj's, y no las huellas.



- 7) Recomendaría usar el mismo calibre de pista de extremo a extremo aunque así pase por capas de placa, como pasa con este GND y varios



Las pistas de GND pueden cumplir diferentes funciones. En general transportan corriente. Para esa función tiene por lo general 1 mm de ancho. Aunque a veces son pistas que alimentan componentes de baja corriente. En esos casos puede tener 0,5 mm o incluso 0,3 mm. Existe otra funcionalidad que es blindar señales. Algunas pistas tienen otras pistas de GND en sus costados, además de la masa en capa inferior. Sirven para aislar la pista de interferencias.

- 8) Cambiar de lugar, quedó la identificación por fuera de la placa o muy al borde



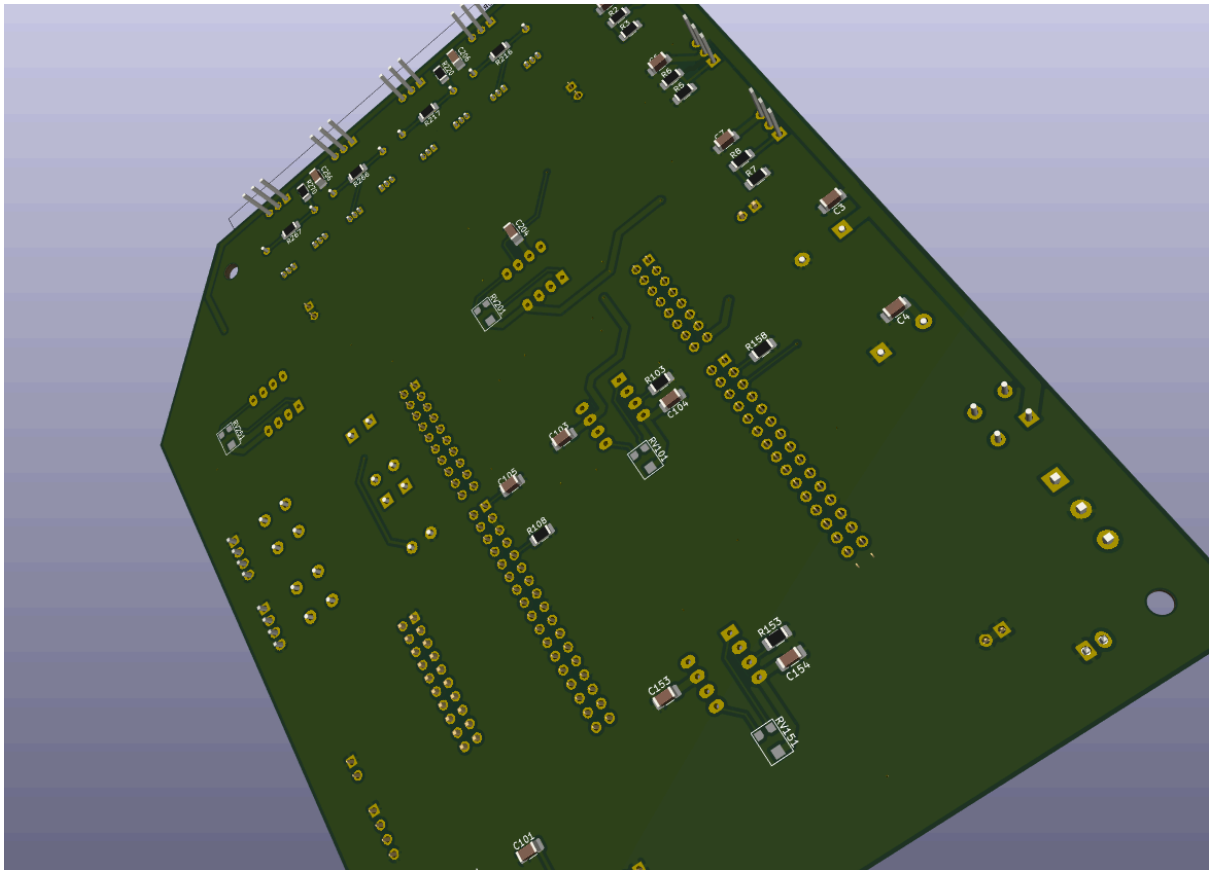
Listo!

- 9) No pondría valores de componentes, podría dificultar la lectura o el armado, cada placa iría con su lista de componentes ordenados numéricamente y por tipo de componente con su respectivo valor, pero no en la placa, se llena de información.



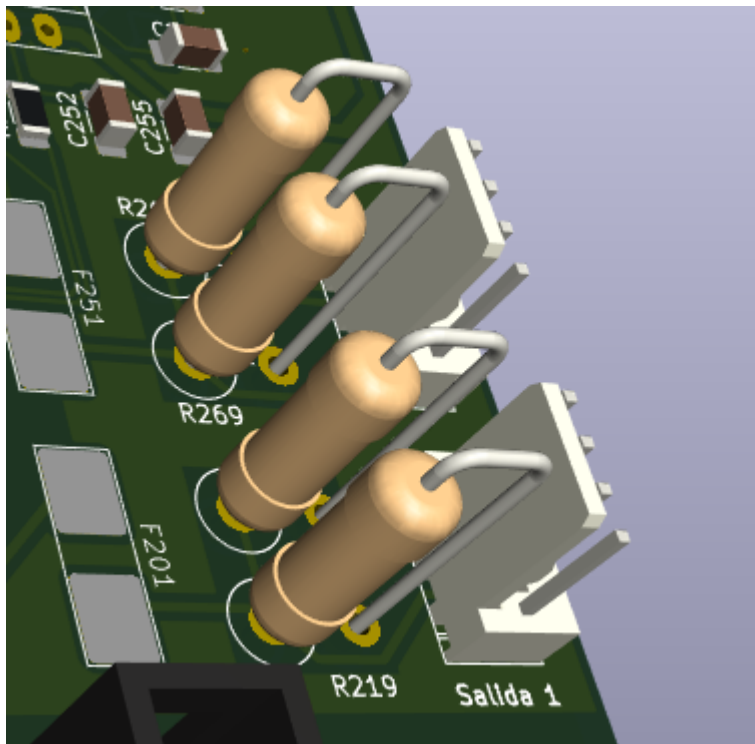
Los valores sólo están puestos en la capa F. Fab y B.Fab.
Esto es complementarios al orden por componente, etc.

- 10) Haría unas referencias visuales de como tendria que ir la placa, como unas líneas o referencias esquemáticas sobre la placa para evitar que se ponga al revés aunque así los pines no permitan la acción

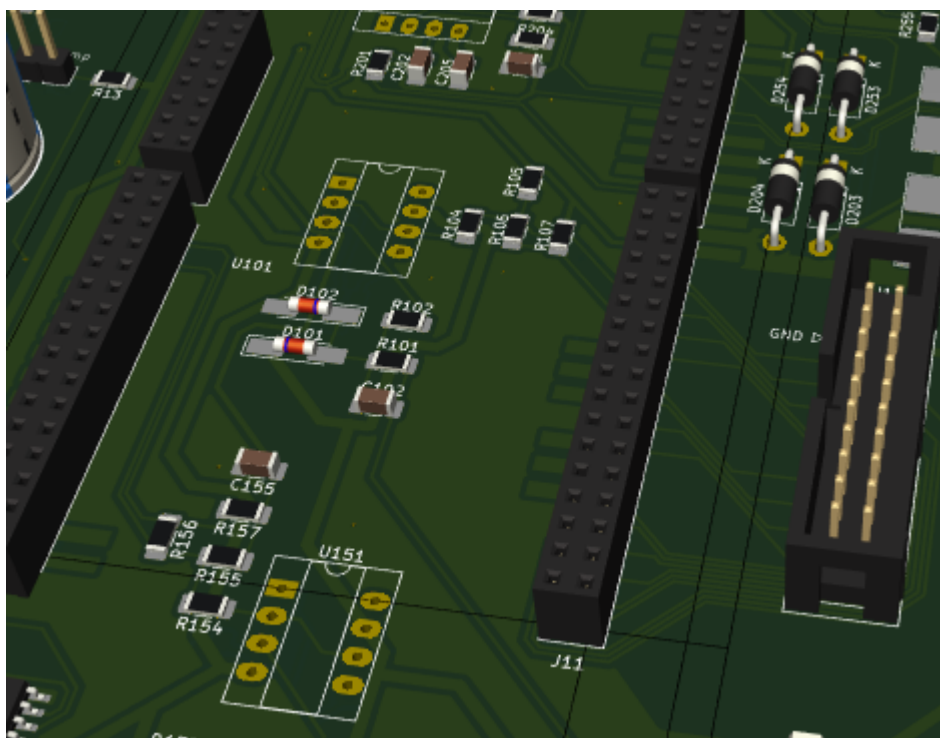


- 11) Capaz tener normalizado el uso de las capas, porque creo que se están mezclando las anotaciones y datos en varias capas, podría ser problemático por confusiones al que hace la placa, el proveedor
- 12) Las resistencias las pondría acostadas en vez de elevadas, si bien ocupará más espacio también serían más fuertes mecánicamente y no incurrirá a roturas por la posición en la que se encuentra.

Corregido!!!



- 13) Pondría alojamiento para tornillo en el medio, aunque podría incurrir en modificar o ser molesto, de esta manera podríamos evitar el “pandeo” o “que se doble” la placa en la manipulación se sacar y poner la placa anexa a esta y así darle mas firmeza mecánica en el armado.



- 14)